



JASDAQ

平成 29 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ・コード6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
(03-3281-8186)

半導体ウェーハ事業における中国杭州市との提携並びに新会社設立に関するお知らせ

当社は、8 インチ半導体ウェーハの 2 次ライン及び 3 次ラインの生産体制の構築を検討して参りましたが、この度、杭州市の開発区委員会（杭州大杭州大江东产业集聚区管委会）と同開発区への進出を前提とした 8 インチ (200mm) 半導体ウェーハ製造プロジェクトにおける資金支援に関する提携契約に合意しましたので、当該プロジェクトにかかわる新会社の設立とあわせ、お知らせいたします。

記

中国では半導体ウェーハの大半を現在でも輸入に依存しており、その為、中国政府は「中国製造 2025」の半導体産業育成政策の中で、半導体製品の国産化比率の向上を図るべく国内の半導体メーカーの育成支援を進めておりますが、現状でも半導体ウェーハを製造出来る中国のサプライヤーの数は限られている状況です。当社は、その中で 2002 年に小口径（6 インチ以下）の半導体ウェーハ事業に進出し、現在では中国における小口径半導体ウェーハの最大手のサプライヤーの一角に成長しております。

また、昨年には世界第 3 位の大手半導体ウェーハ製造・販売会社である台湾の Global Wafers Corporation 社との間で、8 インチ半導体ウェーハの製造、販売に関して業務提携をし、現在、当社の銀川、上海工場にて年内の量産開始に向け準備しております。

このような中で、銀川、上海工場で量産体制を進めております 8 インチ半導体ウェーハにつきましては、量産前段階ながら、既に顧客より引き合いが来ているなど、中国における半導体ウェーハの需要は、供給が追いつかないほどひっ迫している状況であり、この需要に出来る限り早く応えていくことが、中国市場における半導体ウェーハ市場において確固たる地位を築くことに繋がる為、長期的な観点から更なる事業拡大が必要と考えておりました。

一方で、半導体ウェーハの設備投資は巨額の投資となるため、当社としては投資リスクをコントロールしながら、投資負担を軽減する戦略もあわせて模索しておりました。

かかる状況下、今般当社は 1992 年に進出した杭州市を提携パートナーとして選定しました。選定の経緯としましては、最先端半導体産業を誘致したい杭州市と、投資リスク負担を軽減した上で事業展開を図りたい当社の思惑が一致したことに加え、これまでの永年に渡る杭州市への貢献が評価され、本邦企業でありながら今回の提携に至ったものであります。

提携の主な内容としましては、産業支援策と財政支援策の 2 本立てになっており、産業支援策としては、ウェーハ開発・設備購入費用の補助金、財政支援策としてはプロジェクト資金借入時の利子補給となります。

また、当社としましては、本プロジェクトに絡み、新たに半導体ウェーハ開発、設計、製造の新会社を当社グループ100%の子会社として杭州市に設立する予定です。

今回の提携により大口半導体ウェーハにつきましては、将来的に8インチは月産最大45万枚（銀川、上海での生産分15万枚/月含む）の生産体制を構築する為の資金支援体制が強化されたこととなります。加えて、既存の小口径半導体ウェーハの月産最大40万枚とあわせ、当社半導体ウェーハ事業全体で月産最大85万枚の生産体制が構築されることで、中国における半導体ウェーハの最大のサプライヤーになることが期待されます。

尚、本プロジェクトの投資実行に際しましては、その都度、事業計画、市場動向、受注状況、生産体制を精査の上、機関決定を踏まえて慎重に判断していく所存であり、今後の半導体市場の動向次第では、当初計画を変更する可能性がございます。

2. 新会社及び工場建設の概要（予定）

[円表示は1人民元=16.80円で換算（単位未満切り捨て）]

(1)	名 称	杭州中芯晶圆半导体股份有限公司	
(2)	所 在 地	中国浙江省杭州市	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長・総経理：賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	半導体インゴット及びウェーハの開発、設計、製造	
(5)	登 録 資 本	29億元（約487億円） ¹	
(6)	設 立 予 定 年 月 日	2017年9月中 ²	
(7)	大株主及び持株比率 ³	株式会社フェローテックホールディングス 45.0% 杭州大和熱磁電子有限公司 35.0%（当社100%子会社） 上海申和熱磁電子有限公司 20.0%（当社100%子会社）	
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社グループ100%子会社
		人 的 関 係	董事長・総経理に就任予定の賀 賢漢は、当社の代表取締役副社長を兼務しております。
		取 引 関 係	該当なし
		関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当なし
(9)	投 資 期 間	約3年間（2017年末～2020年末）	
(10)	工 場 敷 地 面 積	約159,341 m ²	
(11)	ス ケ ジ ュ ー ル	2017年末まで	工場着工
		2018年末まで	工場完工並びに装置試運転開始
		2019年下半期中	8インチ半導体ウェーハ生産開始

¹段階的に当該登録資本まで増資して行く予定（現物出資を含む）

²当局（工商局、商務局）による許認可の審査状況次第では、設立時期が予定より遅れる場合があります。

³最終的な資本構成

3、契約スケジュール

(1)	取 締 役 会 決 議 日	2017年9月15日
(2)	提 携 契 約 締 結 日	2017年9月17日（予定）

4. 今後の見通し

当社の平成30年3月期の連結業績に与える影響は見込んでおりませんが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上